

ELCOAT P-100

[도전성 수지]

제 품 명

ELCOAT P-100



○ 제 품 설 명

- 플레이크(FLAKE) 형태의 은 분말을 필러로 하여 아크릴계 수지와 저비점의 유기용제가 혼합된 속건성 고전도성 수지
- 유기용제의 증발에 의해 도전막이 형성되어 도전성이 발생
- Microelectronics 분야에 폭넓게 적용 가능하며, 소재에의 대응성이 우수함

○ 제 품 용 도

- 반도체 소자인 다이본딩을 비롯하여 납땀을 할 수 없는 부품의 접착에 사용
- 회로 등의 보수나 전자 현미경의 시료용 전극, 고주파 솔드 등에 사용
- 리드선, 전극의 접착, 반도체 도전막의 보강, EMI용 부품, 인쇄회로 등 정전기 방지 또는 열을 가할 수 없는 부분에 도전을 하고자 할 때 광범위하게 사용

CANS

사 용 방 법

- 필터가 잘 분산되게 원액과 희석용제를 잘 혼합하여 최적의 점성으로 사용 (희석비 : 30 wt % 이내)
- 도포 방법
PIN, BRUSH, DIPPING, MICRO-DISPENSOR 등의 방법으로 목적물에 도포 (스크린 인쇄 불가)
- 사용후에는 희석 용제가 증발하지 않도록 뚜껑을 꼭 닫을것

○ 물 리 적 특 성

- Cure Method 상온경화, 열 경화
- Color
 - wet stage silver
 - cured film silver
- Viscosity (Poise/25℃) 210 ~ 250 (원액기준)
- Specific gravity (25℃) 2.3 ~ 2.5
- Curing Schedule
 - 150℃ × 30 min
 - 25℃ × 24 hr
- 형성막 특성
 - 체적 저항 : 실온, 24 시간 ----- $5 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$ 이하
 - : 150℃ × 30 분 ----- $1.2 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$ 이하
- 액상 특성
 - 고형분 (wt %) ----- 65 ~ 75
- 밀착성
 - Phenolion Board : O
 - Glass : G
 - Copper : O
 - Aluminum : O

CANS

* Instruction *

Adehision : G - 100/100

O - 80/100 more

X - 80/100 less

포 장 단 위

20g, 1KG